



3D・チップレット研究会第2回公開研究会

主催：システムインテグレーション実装技術委員会
協賛：応用物理学会 シリコンテクノロジー分科会、SEMIジャパン

◆公開研究会のご案内

1つのチップにすべての機能を収納する時代(SoC)から、機能ごとにチップを製造し、これらをインテグレーションするチップレットの時代へ移行が始まっています。チップレットには様々な実装構造が議論されており、さらには3DIC(3次元集積化デバイス)も合わせて議論されています。チップレットそして3DICの各種構造に関わる、チップ実装技術、RDL及びインターポーザを含む相互接続技術、パッケージング技術などが、そして製造技術だけでなく、材料技術や設計評価技術が、サプライチェーン/エコシステムを踏まえた上で必要となってきました。これら技術を調・議論するために、今年度から新たに「3D・チップレット研究会」を発足しました。今後は、関係機関と連携し、課題や将来必要となる技術を議論していきたいと考えております。

今回は、3D・チップレット実装に向けた、実際の先端技術開発とその動向についての第1回目として、専門家の方々にご紹介頂き、皆様と一緒に技術課題や方向性を考えてみたいと思えます。また、現地会場ご参加には、昭和電工マテリアルズ様と日本IBM様のご厚意にあずかり、見学会も予定しております。皆様方の積極的なご参加をお待ちしています。

テーマ：『2.xDおよび3D実装技術の最新開発動向(その1)』

開催日時 2022年11月17日(木) 13:00～17:30(予定)

開催方式 会場現地とオンラインのハイブリッド

開催場所 ①新川崎創造のもり・AIRBIC(先着150名様まで):定員締切済

川崎市幸区新川崎7-7(JR横須賀線新川崎駅徒歩10分・JR南武線鹿島駅徒歩15分)

<https://kawasaki-sozonomori.jp/airbic/>

②Zoom Webinar(先着300名様まで)

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します

13:00～13:50

「チップレット集積技術」

東京工業大学 科学技術創成研究院 特任教授 栗田 洋一郎 先生

13:50～14:40

「前工程領域技術を用いた高密度チップレット配線形成」

横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授 井上 史大 先生

(休憩10分)

14:50～15:40

「インテルのパッケージング技術」

インテル株式会社 アセンブリ・テスト技術開発部 富田 至洋 氏

15:40～16:30

「半導体後工程R&D拠点”JOINT2”の取り組み」

昭和電工マテリアルズ株式会社理事、パッケージングソリューションセンタ長 阿部 秀則 氏

16:30～17:30 (会場①参加者に限らせていただきます)見学会⇒ パーチャルツアー

(A)昭和電工マテリアルズ様、

パッケージングソリューションセンタ(JOINT2)の見学[先着90名様まで]

(B)日本IBM様

量子コンピュータの見学[先着60名様まで]: 定員締切済

※(A)(B)のどちらか一方を選択できます。不要の場合は選択しないでください。

※会場②での見学会はありません、会場②での終りは16:30の予定です。(訂正)ツアー有

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

参加要項

定員 会場① ~~150名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)~~ 定員締切済
会場② 300名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:3,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円

名誉会員:無料、賛助会員の社員:3,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:10,000円 非会員学生:2,000円 協賛団体会員:3,000円

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
 - ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:銀行振込・クレジットカード決済)
 - ③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
 - ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
 - ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。
 - ⑥ご講演者および見学先からの要求がありましたら、参加者情報(ご所属・お名前・メールアドレス)を提供致します。ご了承ください。
- *キャンセルポリシー
お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

①現地参加の方
会員/賛助/非会員

②WEB参加の方
会員/賛助/非会員

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

講演資料、講演内容、研究会についての問い合わせ: <https://forms.gle/Lv6wcY76fYAw9V156>

お申し込みについての問い合わせ: info@jiep.or.jp (メールアドレスは@を¥に置き換えてください)